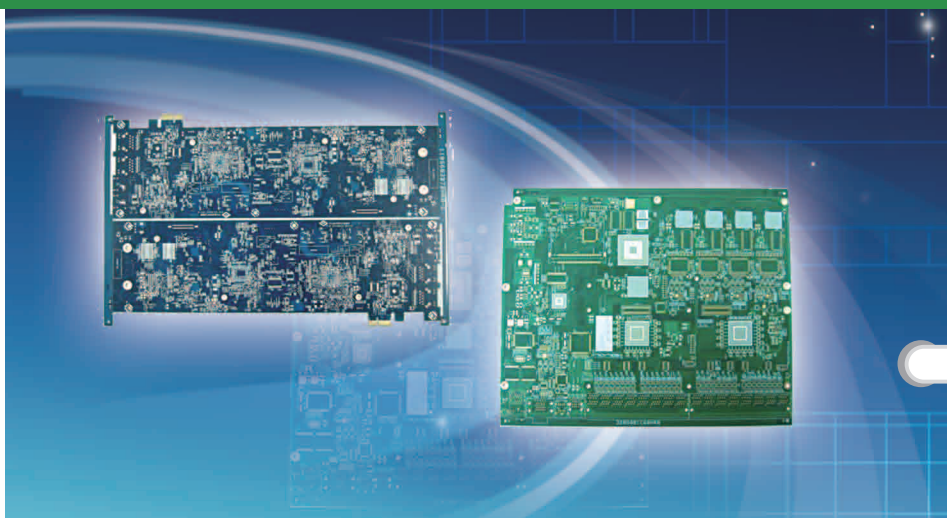


博智電子 股份有限公司



公司簡介

博智電子於 84 年成立，致力於印刷電路板之製造及銷售，主要大股東為仁寶及金仁寶集團，持股比例約 6 成。成立之初以 NB 板等大宗化產品為主，營運較為艱辛，於張董事長永青與洪總經理輝龍陸續到任後，於 97 年度起再開始重新審視市場現況，藉由明確的市場區隔與產品定位，化劣勢為優勢，並於 98 年度首次轉虧為盈，98~100 年度及 101 年前三季營業收入及每股盈餘分別為 10.2 億元、13.4 億元、14.6 億元及 11.9 億元與 0.52 元、2.26 元、2.61 元及 3.04 元，且 101 年 10 月單月自結營收 1.5 億。每平方呎產品平均單價 98 年度到 101 年度前三季度由 616 元逐期提升至 933 元，產品轉型成功且奏效。

產業現況與發展

一、產業概況

印刷電路板 (Printed Circuit Board, PCB) 是組裝電子零組件之前的基板，功能在於電子連接及承載元件，是提供電子零組件安裝與互連時的主要支撐體，為所有電子產品不可或缺的基礎零件，被廣泛的應用在資訊、通訊、消費、國防及工業等各項電子產品中，具有承載電子零件，傳遞電源及訊號之功能，

其需求則隨著電子技術之日益精進而穩定成長。

二、產業未來發展

我國 PCB 產業挾帶成本控制能力強和生產產品品質優異的特性，屢獲全球終端電子產品採用作為產品所需的電路板。根據工研院 IEK 調查統計 2011 年我國 PCB 產業的產值為 4,011 億新台幣，較 2010 年產值成長 2.64%。隨著歐債問題正逐步找到解決方案，和美國景氣正緩步復甦的帶動之下，且我國匯率波動預期在 2012 年將會較為趨穩，在新電子產品如 Smartphone、Tablet PC、Ultrabook 等需求持續增溫之下，將持續拉升我國 PCB 產值，預估 2012 年我國 PCB 產值將較 2011 年成長 3.73%，達到 4,161 億新台幣規模。

競爭優勢

目標市場鎖定在少量多樣的高階伺服器及工業電腦等產品上，與同業公司多著重在以電腦及各式消費性電子產品而有所不同。因高階伺服器及工業電腦等產品在技術與品質上要求甚高，在面對未來高階伺服器與工業電腦之市場要求性不斷提高下，博智電子競爭優勢如下：

一、具備大廠所擁有的先進技術：與博智電

子產品型態相似的同業競爭者 (技術能力較高的 PCB 大廠) 中，博智電子的技術能力在線寬 / 線距，BGA Pitch(球柵陣列式組裝)，HDI(高密度連接技術) 疊構，阻抗控制能力及 Sequential(逐次壓合增層法) 製程等，均優於競爭對手。

二、擁有樣品廠的生產彈性及機動性：博智電子生產流程之安排具彈性，可符合伺服器 / 工業電腦客戶之供貨需求，可解決伺服器 / 工業電腦客戶在下單給一級廠時，往往於旺季時遇到因量少拿不到產能而造成產品交貨延宕情形。

三、與材料供應商及客戶協同開發，提昇公司附加價值：透過外訓與邀請客戶研發人員來廠講習，加強博智電子設計與工程人員對產品電性的概念與應用，且積極的參與客戶的研發過程並提供客戶 PCB 相關材料與製程的專業意見，藉此與客戶保持良好之互動關係，使其合作關係更為穩定並提昇公司附加價值。

四、發展獨特的 e 化生產管理系統：博智電子運用自行研發之 e 化生產管理系統 (例：生產批量管控系統、自動化全面品質管理系統、自動良率警報系統、生產工具管理中心、WIP 自動鎖定系統、重點生產設備係數監控系統、樣品條件系統化 (eNPI) 等) 來提升產品品質、信賴度及生產良率並快速因應未來市場產品需求。

五、透過持續累積高技術能量，除伺服器與



工業電腦市場外，對於未來其他市場的開發，將有更多的彈性。

未來展望

博智電子將積極投入關鍵性生產技術及設備，如梢釘層壓板 (Pin Lamination)、背鑽、雷射鑽孔、垂直連續電鍍、水平連續電鍍孔等，使博智電子之產製技術大幅成長，生產方面，持續改善高階產品的技術與管理能力，並提高良率，亦持續導入資訊化管理系統以提高管理與生產效率。降低成本方面，持續開發新供應商及替代物料來降低原物料成本，並導入資訊化自動化系統，提高生產效率，降低人事成本，且成立成本與效益改善專案，降低營運成本。市場方面，開發高階、高層次產品市場，提高高階 HDI 及 Server/IPC 等高附加價值產品的比例，藉由技術的提升，更可快速配合客戶需求調整，預期將為博智電子帶來新一波的成長契機。

印刷電路板之下游應用：

分類	特性	下游產品應用
硬質電路板	不具可撓性	電視機、錄放影機、計算機、縫紉機、收錄音機、遊樂器、電話機、傳真機、手機、數位相機、個人電腦、筆記型電腦、伺服器、工業電腦、通訊設備、數值控制設備、自動交換機、半導體測試設備及電腦周邊設備等
軟性電路板	具可撓性、易轉折、重量輕、厚度薄	手機、數位相機、筆記型電腦及觸控面板等
HDI 板	體積小、速度快、頻率高	通訊、高性能系統主機板、可攜式電腦、手機及個人數位助理、數位相機等
IC 載板	更輕、體積更小，且品質穩定度及訊息通路均優	晶片組、繪圖晶片、快閃記憶體、邏輯 IC、Flash 及高速 DRAM 等